PCT WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION

International Bureau

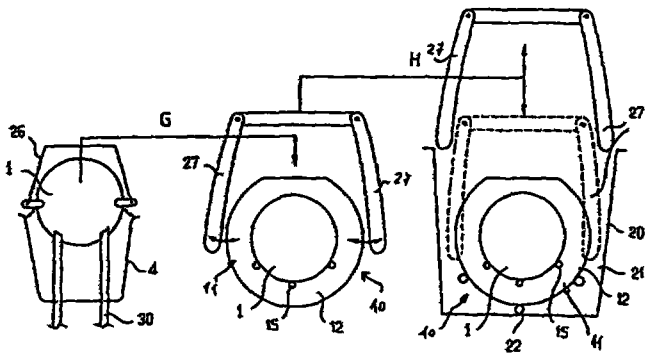
INTERNATIONAL APPLICATION PUBLISHED UNDER THE PATENT COOPERATION TREATY (PCT)

(51) International patent classification[6]: H01L 21/00 A1	(11) International publication number: WO 99/46802
	(43) International publication date: 16 September 1999 (16.09.99)
(21) International application number: PCT/FR99/00520	(81) Designated states: JP, KR, SG, US, European Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).
(22) International filing date: 9 March 1999 (09.03.99)	
(30) Data relating to the priority: 98/02,833 9 March 1998 (09.03.98) FR	Published With the International Search Report.
(71) Applicant *(for all designated States except US)*: S.O.I.TEC SILICON ON INSULATOR TECHNOLOGIES [FR/FR]; Parc Technologique des Fontaines, Chemin des Franques, F-38190 Bernin (FR).	
(72) Inventor; and (75) Inventor/Applicant *(US only)*: LAMURE, Jean-Michel [FR/FR]; Hameau de l'Eglise, F-38420 Saint-Jean-le-Vieux (FR).	
(74) Representatives: MARTIN, Jean-Jacques etc.; Cabinet Regimbeau, 26, avenue Kléber, F-75116 Paris (FR).	

As printed

(54) Title: INSTALLATION AND METHOD FOR CHEMICAL TREATMENT OF MICROELECTRONICS WAFERS

(54) Titre: INSTALLATION ET PROCEDE DE TRAITEMENT CHIMIQUE DE PLAQUETTES POUR LA MICRO-ELECTRONIQUE



(57) Abstract

The invention concerns a installation for treating wafers (1) made of material serving as microelectronics substrates, comprising: a basin (20) for containing a treating bath (21) and provided with means for holding (22) the wafers capable of receiving at least one wafer of a first size; and prehensile means (27) for grasping each wafer of a first size, to place it in the bath and remove it therefrom. The invention is characterised in that it further comprises a support (10) for receiving at least one wafer (1) of a second size smaller than the first size, said support having a shape such that it can be grasped by the prehensile means (27) and be received by the basin (20) wafer-holding means (22).

(57) Abrégé

L'invention concerne une installation de traitement de plaquettes (1) de matériau servant de substrats pour la micro-électronique, comprenant: un bac (20) destiné à contenir un bain (21) de traitement et muni de moyens porte-plaquettes (22) apte à recevoir au moins une plaquette d'une première dimension; et des moyens de préhension (27) aptes à saisir chaque plaquette de la première dimension, pour la mettre dans le bac et la sortir de celui-ci; caractérisé en ce qu'il comporte en outre un support (10) apte à recevoir au moins une plaquette (1) d'une deuxième dimension inférieure à la première dimension, ce support présentant une géométrie telle qu'il peut être saisi par les moyens de préhension (27) et être reçu par les moyens porte-plaquettes (22) du bac (20).